



汎銓科技 半導體產業高階製程领航者

www.msscrops.com



汎銓科技股份有限公司

2025 Q1 營運概況

- This report contained herein is the exclusive intelligent property of MSSCORPS CO., LTD and shall not be distributed, copied, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior permission.
本報告為汎銓科技股份有限公司之智慧財產權，非經本公司書面授權許可，不得透露或使用本報告，亦不得複印、複製或轉變成其他任何形式使用。
- The results in this report are solely based on data, information, and/or samples provided by the applicant. All contents in this report shall be treated as whole, separated usage (texts or images) is invalid.
本報告僅就委託者之委託事項提供分析結果，報告分離使用無效。
- This report is for reference only. Please consult MSSCORPS CO., LTD first for other purposes, such as advertisement, sales promotion, notarial, or lawsuit.
本報告所載事項僅作參考資料，若貴公司擬作為廣告、商業推銷、公證、法律訴訟之用途，請先諮詢本公司同意。

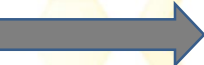
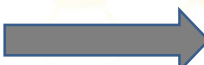
免責聲明 Disclaimer

- This presentation includes forward-looking statements. All statements, other than statements of historical facts, that address activities, events or developments that Material Science Service Corp. expects or anticipates will or may occur in the future (including but not limited to projections, targets, estimates and business plans) are forward-looking statements.
- MSS's actual results or developments may differ materially from those indicated by these forward-looking statements as a result of various factors and uncertainties, including but not limited to market demand, change in legal, financial and regulatory frameworks, government policies, financial market conditions, and other risks and factors beyond our control.
- MSS does not undertake any obligation to publicly update any forward-looking statement to reflect events or circumstances after the date on which any such statement is made or to reflect the occurrence of unanticipated events.

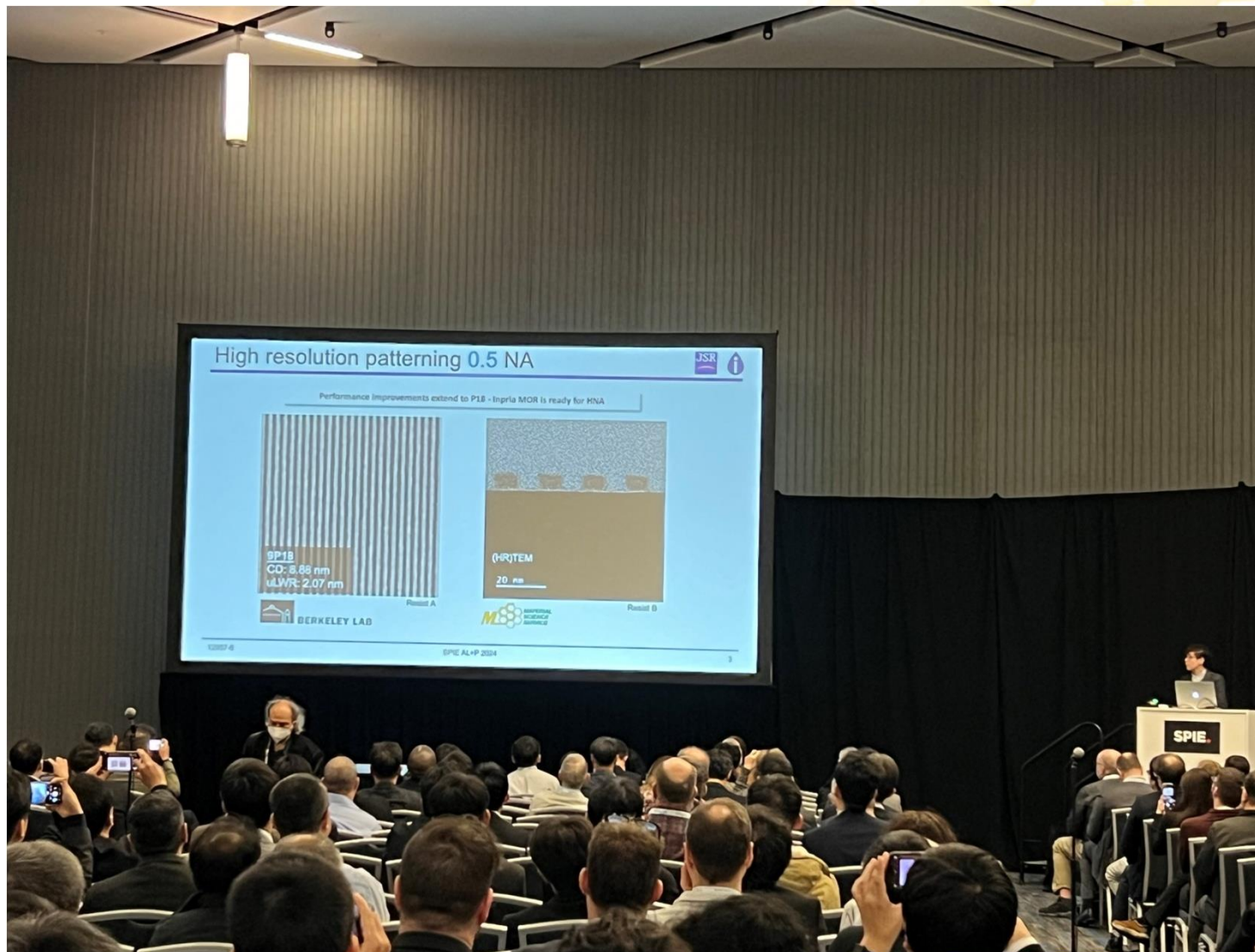
以汎銓角度看目前「分析檢測市場」

- 聚焦 A⁰ 世代先進製程、矽光子、AI 晶片分析，案件需求持續增加
- 第二類、第三類、CMOS影像感測器、高壓元件、成熟邏輯及記憶體等相關應用的客戶族群，面對中國成本競爭的壓力下，其委託量趨緩
- 2024年積極海外佈局，不僅不受關稅壁壘之影響且受惠海外市場委案增加

汎銓分析技術分類與成長性

分類	屬別	技術名稱	MSS 強項	說明	2024 全年 業績占比	2025 Q1 業績占比	2025~2026 展望
先進製程 (A ⁰ 世代)	MA	光阻保護技術	第三代EUV光阻保護技術	金屬氧化物光阻	54.7%	54.3%	
	MA		先進光阻保護技術	EUV光阻/蝕刻 結構分析			
	MA		選擇性沉積試片製備技術	特殊ALD 鍍膜			
	MA	low-k 保護技術	BEOL: low-k結構保護技術	應用材料發表 black diamond 材料			
	MA		BEOL: low-k介電損傷分析技術	low-k介電質成分分析			
	MA		新穎二維(2D)材料分析方式	弱鍵結材料分析			
	MA	超薄試片工法	超薄試片保護工法	2nm/A14 元件結構分析			
	MA		FEOL: GAA 蝕刻副產物價態分析	2nm/A14 元件成分分析			
	MA		MEOL: ALE 蝕刻副產物比較平台				
	MA		高深寬比結構TEM分析技術	DRAM cell 分析			
	MA	自動量測	利用人工智慧運用於自動量測的方式	大量/可靠/精準量測			
成熟製程	MA	透鏡球高/透鏡 defect	光學元件分析技術: 透鏡球高/透鏡defect	CIS	12.7%	9.4%	
	MA		穿戴式裝置AR/VR產品鏡片整合分析	Meta Lens/Pancake Lens			
	MA	化合物半導體	磊晶缺陷量化分析技術	GaN on Si			
	MA		化合物半導體中載子濃度分佈影像	GaAs/InP/SiC			
	MA		整合型應力分析技術	PA放大能力(繞射圖案分析)			
	MA	OLED	超低對比結構材料分層顯像技術	高分子影像分析			
	MA	CCL/FCCL	軟性材料切片技術	無刀痕/void			
IC 故障分析	MA		一般材料分析(SEM/FIB CS/Reversed MA/SIMS)		9.8%	10.6%	
	FA	化合物半導體	高壓高溫量測 (1000V 300C)	GaN/SiC			
	FA		電性超薄樣品製備技術	GaN/GaAs/SiC/3nm HPC InGaAs電測技術			
	FA	電路修補技術	訊號引線技術	拉線直接量測IC 內單一邏輯閘功能			
	FA		Backside訊號引線技術				
	FA		外掛多顆被動元件技術	先進製程 IC			
	FA		精準去除局部RDL技術	WLCS/FO IC 專用			
	FA		Filpchip front side FIB技術	Flipchip IC			
矽光子 & AI 晶片	MA	矽光子結構	矽光子/大面積快速切削/導電/低刀痕製備	矽光子TEM分析需要精準去層/提升大片波導材料導電率/降低波導元件所造成的窗簾效應	5.7%	7.0%	
	FA	矽光子光電測試	矽光特性、光衰的檢測	檢測平台耦合導光進入PIC 內波導，經過分光/濾光/極化等功能元件，再耦合矽光檢測平台光纖，用來偵測光的品質			
	FA		矽光子矽光路異常定位、斷路、漏光檢測				
	FA		12吋矽光子光測平台，具備全自動對光掃描耦合				
	MA	先進封裝	PFIB/hybrid metal bond/TSV分析技術	3D IC bond 對準&接面氧化物/TSV TEM			
	FA	先進製程IC故障分析	3nm製程去層次技術/um to nm 定位/E beam probe 離子束前製備技術	通過3家科技公司在3nm產品上的驗證			
	FA	先進封裝	大型IC封裝與載板分離技術/THZ-TDR 斷路/Thermal xyz 定位/3D Xray	專利保護/先進封裝精準定位到Sum			
海外	MA	特殊ALD 鍍膜/超薄試片技術	先進光阻保護/low-k結構保護/高深寬TEM 等技術		17.1%	18.7%	

□ 參與下一世代high NA EUV 曝光機使用MOR (金屬層氧化物)EUV 光阻的研發



全面啟動 各營運廠區-台灣

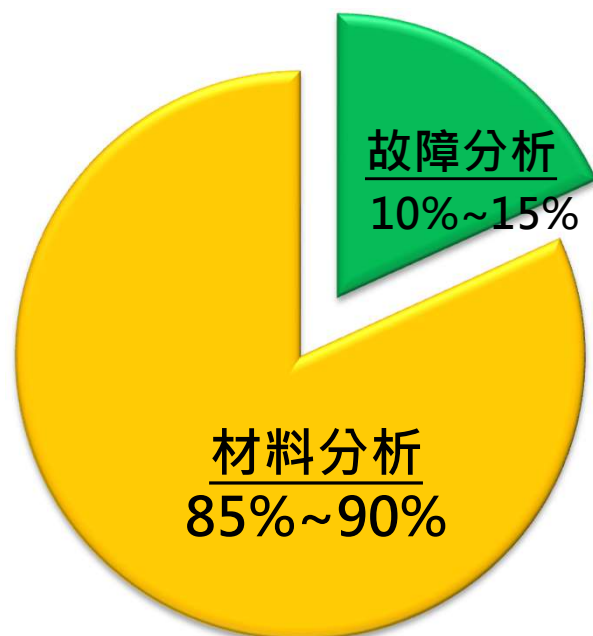
- 材料分析本部+竹北二廠：1.4奈米及以下製程的材料分析
- 營運總部擴建「矽光子測試及定位分析」專區
- 竹北一廠為「AI客戶專區」
- 埃米世代材料分析-「SAC-TEM Center」預計2025Q3投入營運
- 竹北三廠 2026年起將規劃為「AI客戶專區」及「矽光子測試及定位分析」

全面啟動 各營運廠區-海外

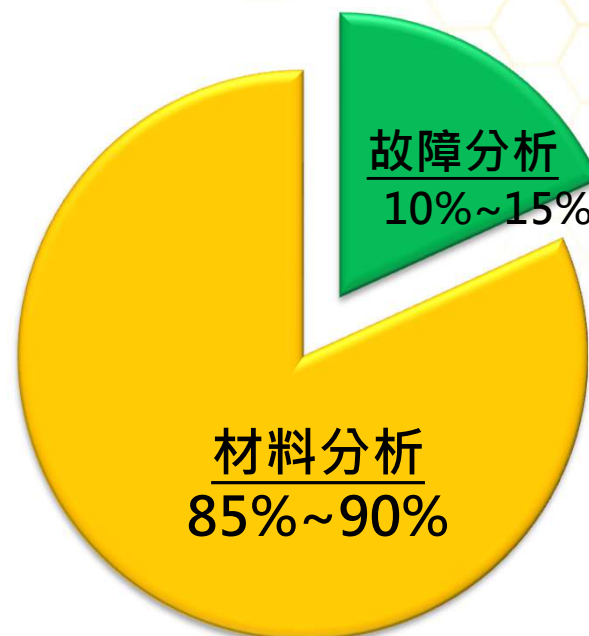
- 南京泛銓：已取得「高新技術企業」資質，享受稅收減免優惠政策，擴增深圳廠區(將於2025/07啟用)
- MSS USA CORP.：已於2025/05開幕，投入營運
- MSS Japan 株式會社：實驗室建置中，預計2025Q3投入運營
- 因應客戶邀約，將於歐洲設立營運據點

近期法人關注議題~產品組合變化

2024 Q1

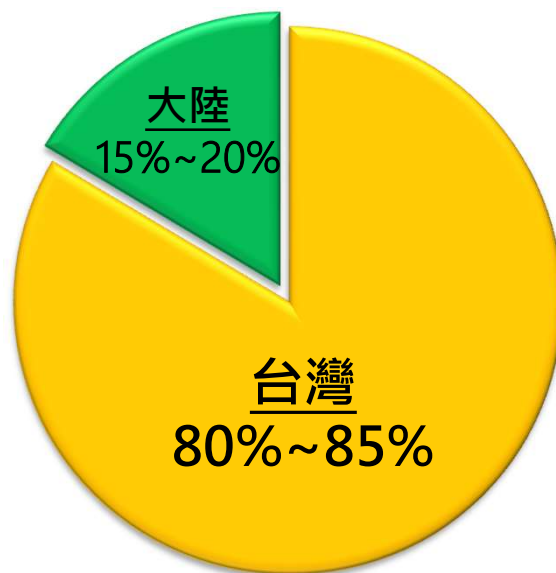


2025 Q1

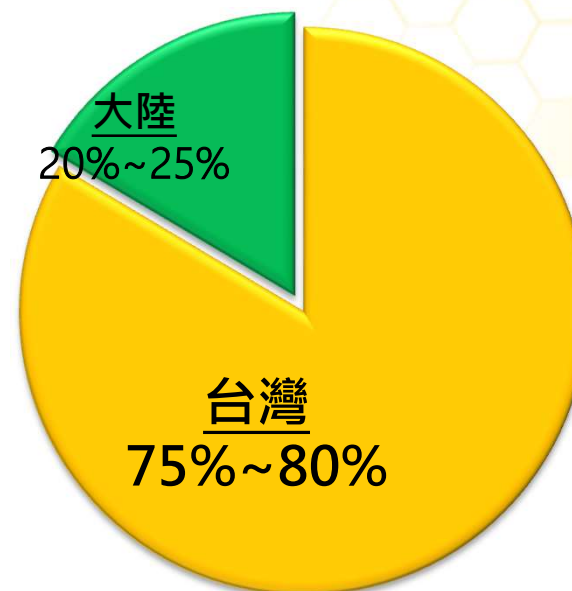


近期法人關注議題~市場組合變化

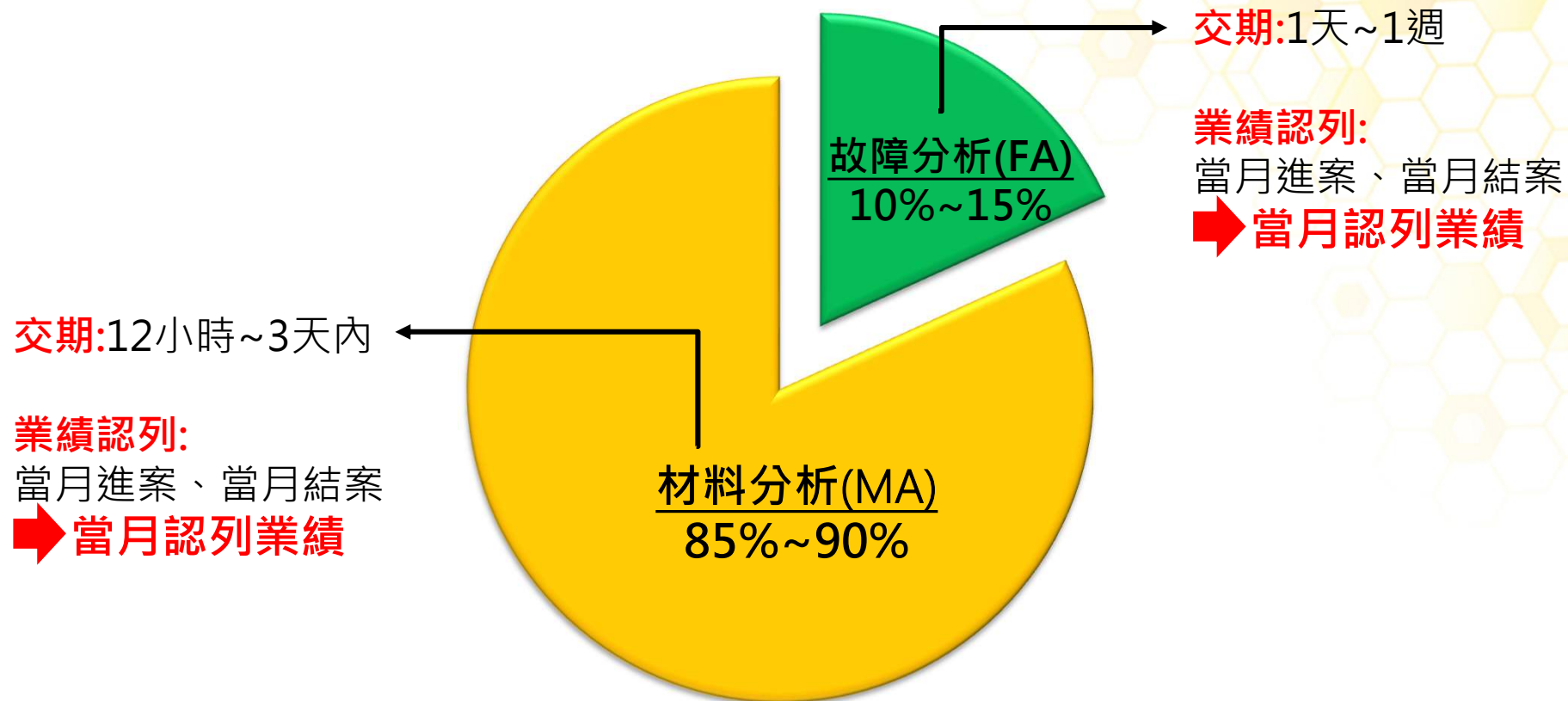
2024 Q1



2025 Q1



產品組合-2025Q1



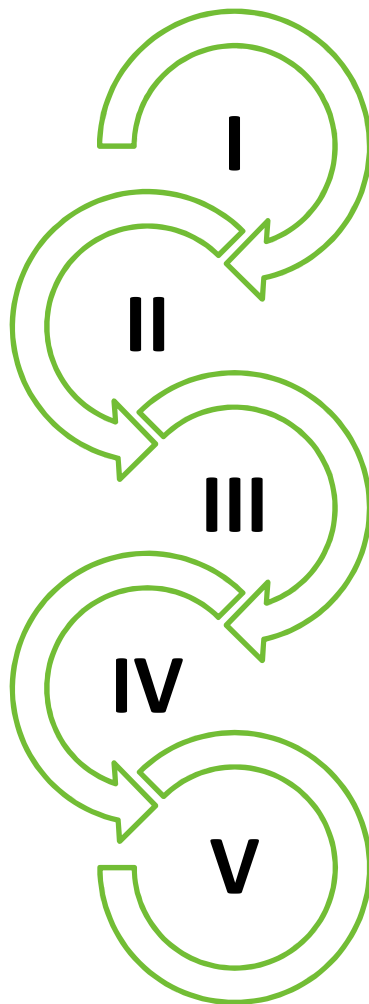
近期法人關注議題～人數變化

2024 VS 2025 Q1

季度	Q1	Q2	Q3	Q4
2024年度人數	605	615	630	650
2025年度人數	680	-	-	-

附錄、公司簡介

公司基本資料



汎銓科技股份有限公司
MSSCORPS CO.,LTD.(英文簡稱:MSS)

設立時間: 民國94年7月27日

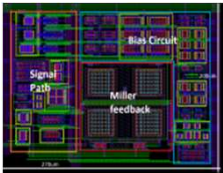
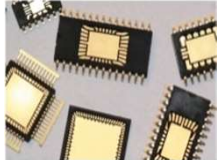
上市掛牌: 民國111年8月31日

創辦人: 柳紀綸董事長兼總經理

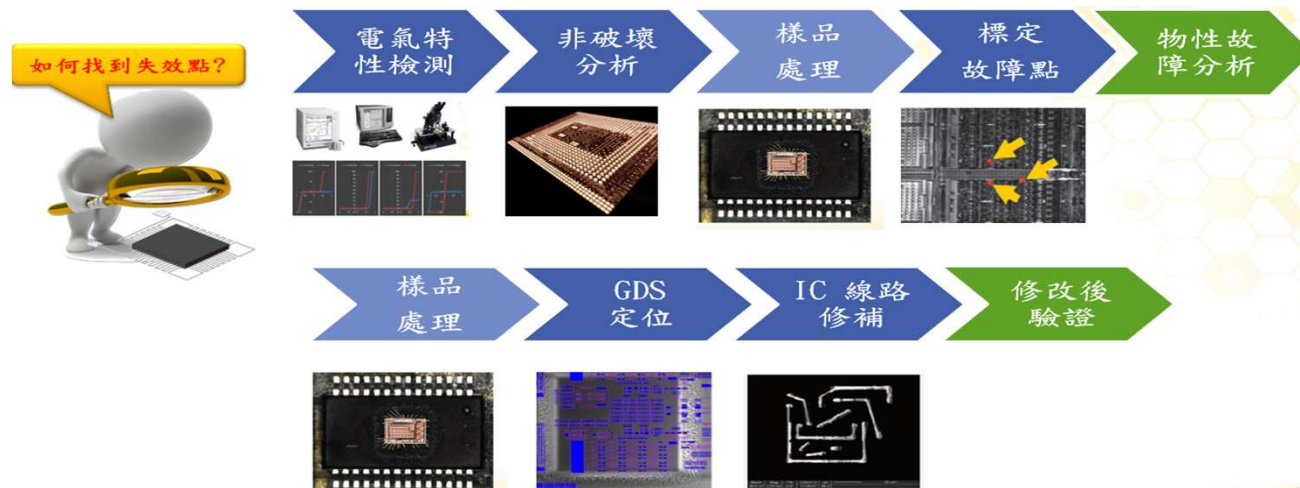
資本額: 新台幣5.18億元/員工: 680人

服務項目: 材料分析服務(MA)、故障分析服務(FA)

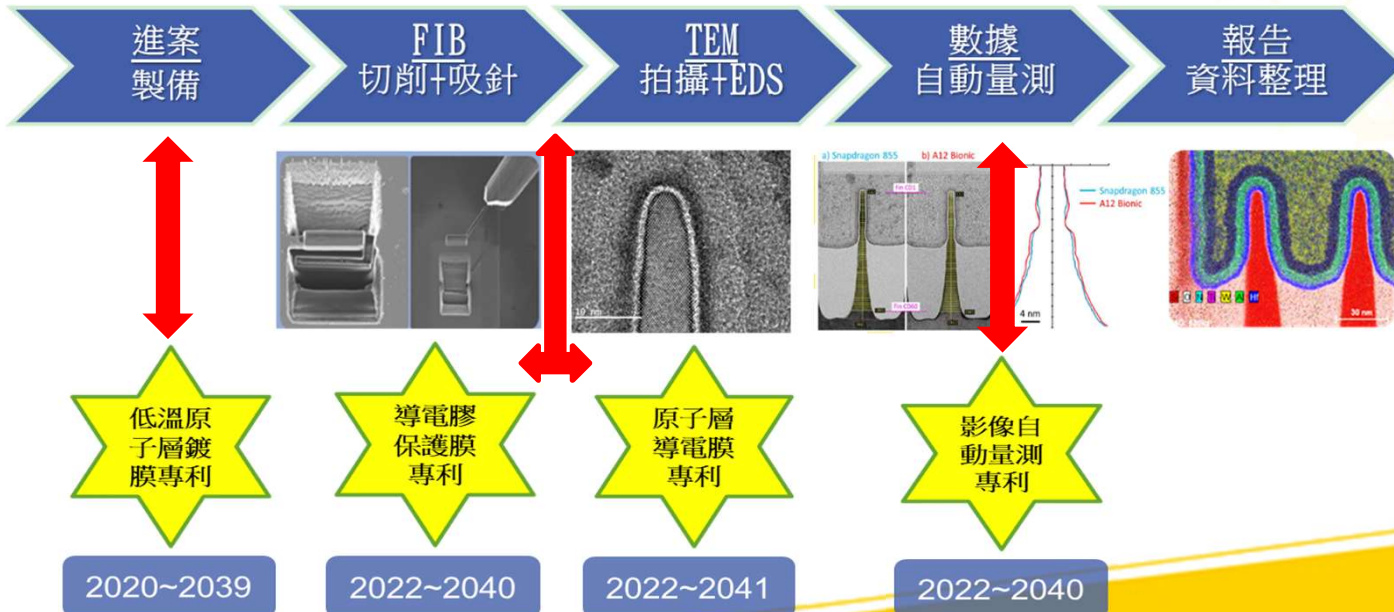
汎銓在半導體產業鏈扮演的角色-FA

項目&定位	內 容
故障分析 服務 (IC產品醫院)	IC設計/光罩  IC設計除錯與找出IC故障真因，讓客戶產品快速Time to market 1.IC電路修補，讓designer找出設計錯誤點，並確認更改設計的有效性 2.IC量產後，針對不良品，進行電測/故障點標定/結構/成份分析 運用 EFA & PFA 技術找出IC故障真因
	封測/載板/ 軟板/PCB 等  汎銓的低損傷分析技術，從晶圓代工取得絕對優勢，擴展到半導體下游 1.材料多樣性/硬度差異/越做越薄/層和層結合力越來越弱 2.開發一系列保護試片專利，減少熱和電的影響，避免產生人為缺陷

故障分析 流程



汎銓在半導體產業鏈扮演的角色-MA

項目&定位	內 容	
材料分析服務 (研發領航者)	 晶圓代工/設備/材料	提供電晶體結構與成份分析，讓FAB 快速達成以下任務 汎銓技術停滯或速度變慢，我們的客戶研發時程就會延誤！ 1.研發最先進製程，決定 新設備的機型/新材料/製程參數 2.導入量產，新建產線的機台，必須證明與RD line 一致性 3.量產中，產線持續良率提昇
材料分析流程	 The flowchart illustrates a five-step process: 進案製備 (Case Preparation) → FIB 切削+吸針 (FIB Cutting + Needle Suction) → TEM 拍攝+EDS (TEM Imaging + EDS) → 數據自動量測 (Data Automatic Measurement) → 報告資料整理 (Report Data整理). Below the steps are four patent icons: 低溫原子層鍍膜專利 (Low Temperature ALD Patent), 導電膠保護膜專利 (Conductive Adhesive Protection Film Patent), 原子層導電膜專利 (Atomic Layer Conductive Film Patent), and 影像自動量測專利 (Image Automatic Measurement Patent). Red double-headed arrows connect the first and second steps, and the third and fourth steps.	
專利名稱	低溫原子層鍍膜專利 導電膠保護膜專利 原子層導電膜專利 影像自動量測專利	
專利期間	2020~2039 2022~2040 2022~2041 2022~2040	

合併綜合損益表

(新台幣/千元)	114年Q1	113年Q1
勞務收入	464,693	434,851
營業毛利	61,123	109,406
毛利率 %	13	25
營業費用	(109,025)	(91,481)
營業外收支	(3,051)	(7,509)
稅前淨利	(50,593)	10,416
所得稅費用	2,088	(19,979)
本期淨利	(48,865)	(9,563)
EPS(元)	(0.94)	(0.20)

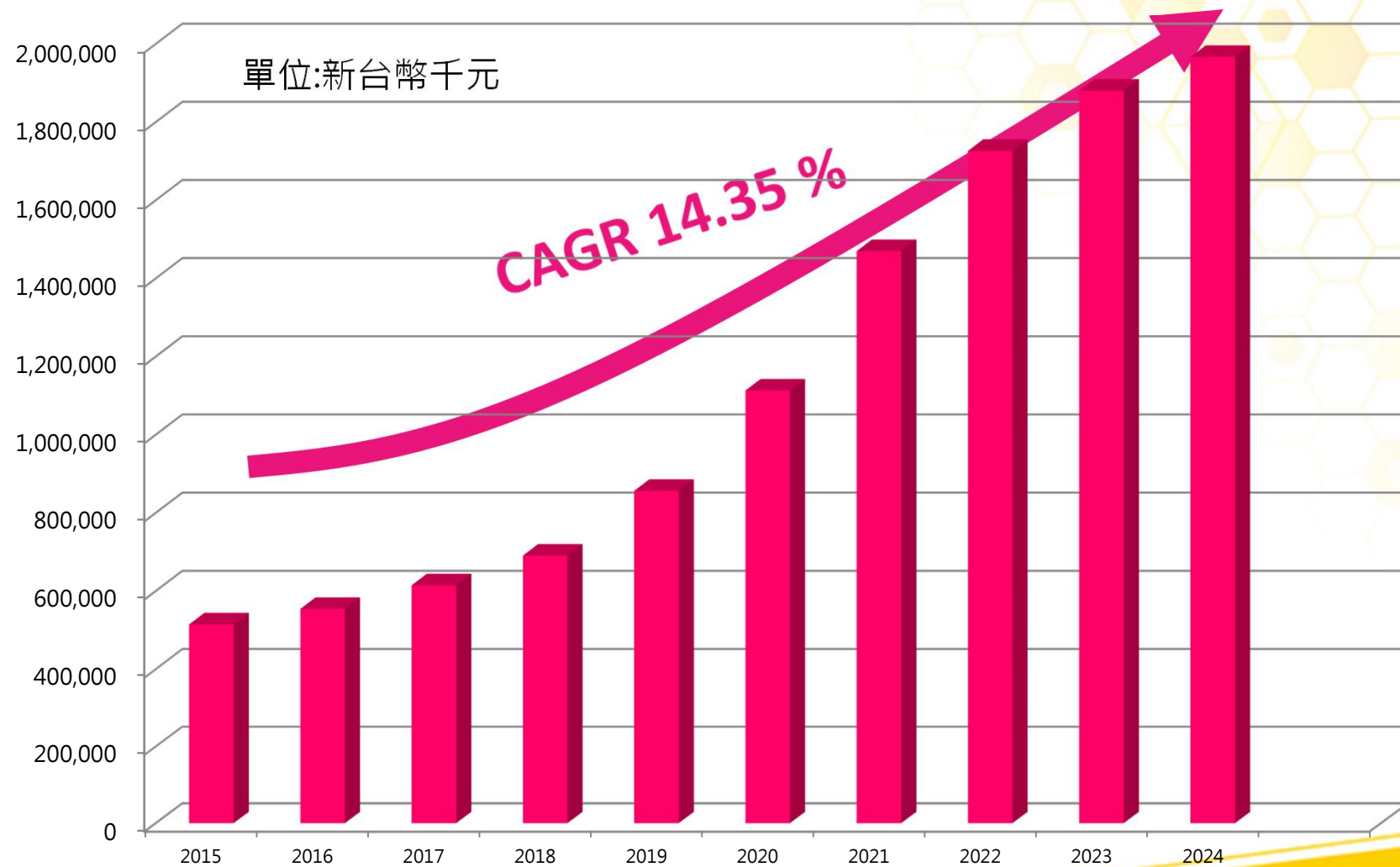
合併資產負債表

(新台幣/千元)	114/03/31		113/03/31	
	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	1,131,940	19%	713,736	15%
應收帳款	666,498	11%	600,275	13%
預付款項及其他流動資產	193,048	4%	141,200	3%
不動產、廠房及設備	3,274,627	55%	2,410,914	52%
使用權資產及其他非流動資產	636,253	11%	791,336	17%
資 產 總 計	5,902,366	100%	4,657,461	100%
短期借款&一年內到期之長期借款	240,667	4%	186,767	4%
應付帳款及其他應付款	201,509	4%	393,415	8%
其他流動負債	146,395	2%	345,302	8%
可轉換公司債	470,860	8%	-	-
長期借款	1,430,869	24%	1,106,082	24%
其他非流動負債	279,497	5%	244,660	5%
負 債 總 計	2,769,797	47%	2,089,459	45%
權 益 總 計	3,132,569	53%	2,568,002	55%

合併現金流量表

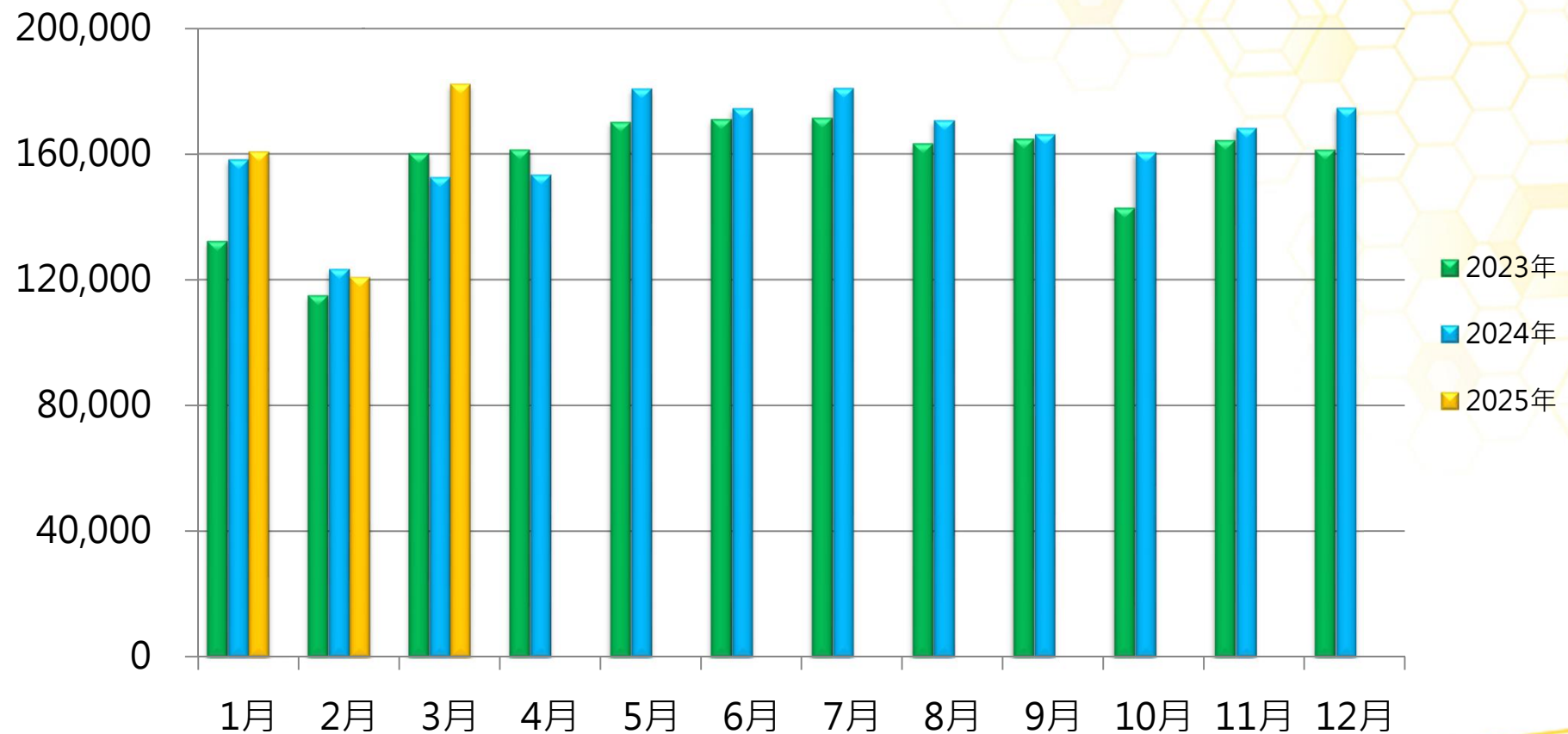
(新台幣/千元)	114年Q1	113年Q1
期初現金及約當現金餘額	1,181,200	622,110
營業活動之現金流量	104,325	152,600
購置不動產、廠房及設備	(259,438)	(404,176)
舉借長短期借款	207,000	411,000
償還長期借款	(104,589)	(45,864)
其他	3,442	21,934
期末現金及約當現金餘額	1,131,940	713,736

最近十年度營收成長趨勢

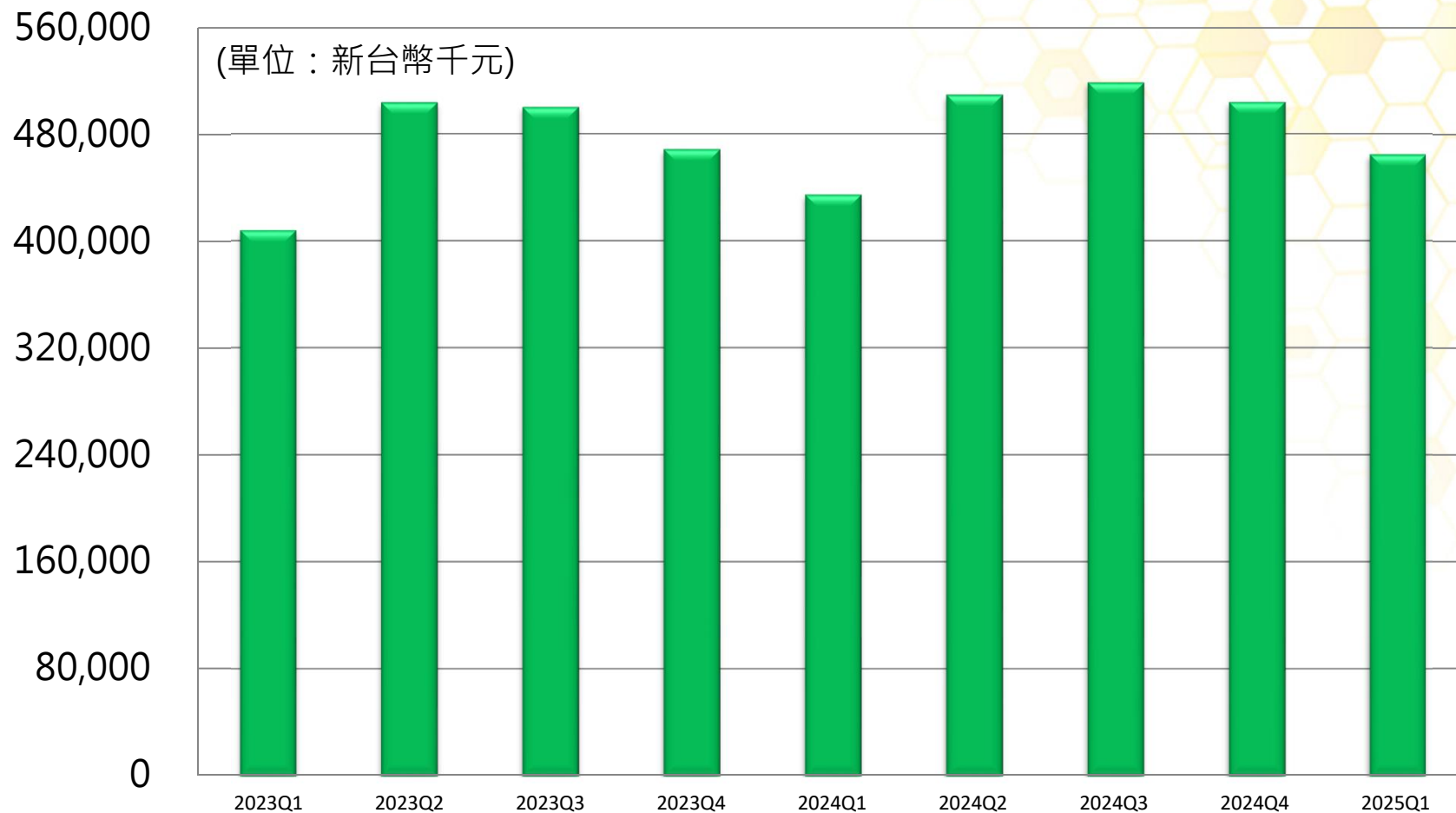


2023~2025年度 月營收趨勢

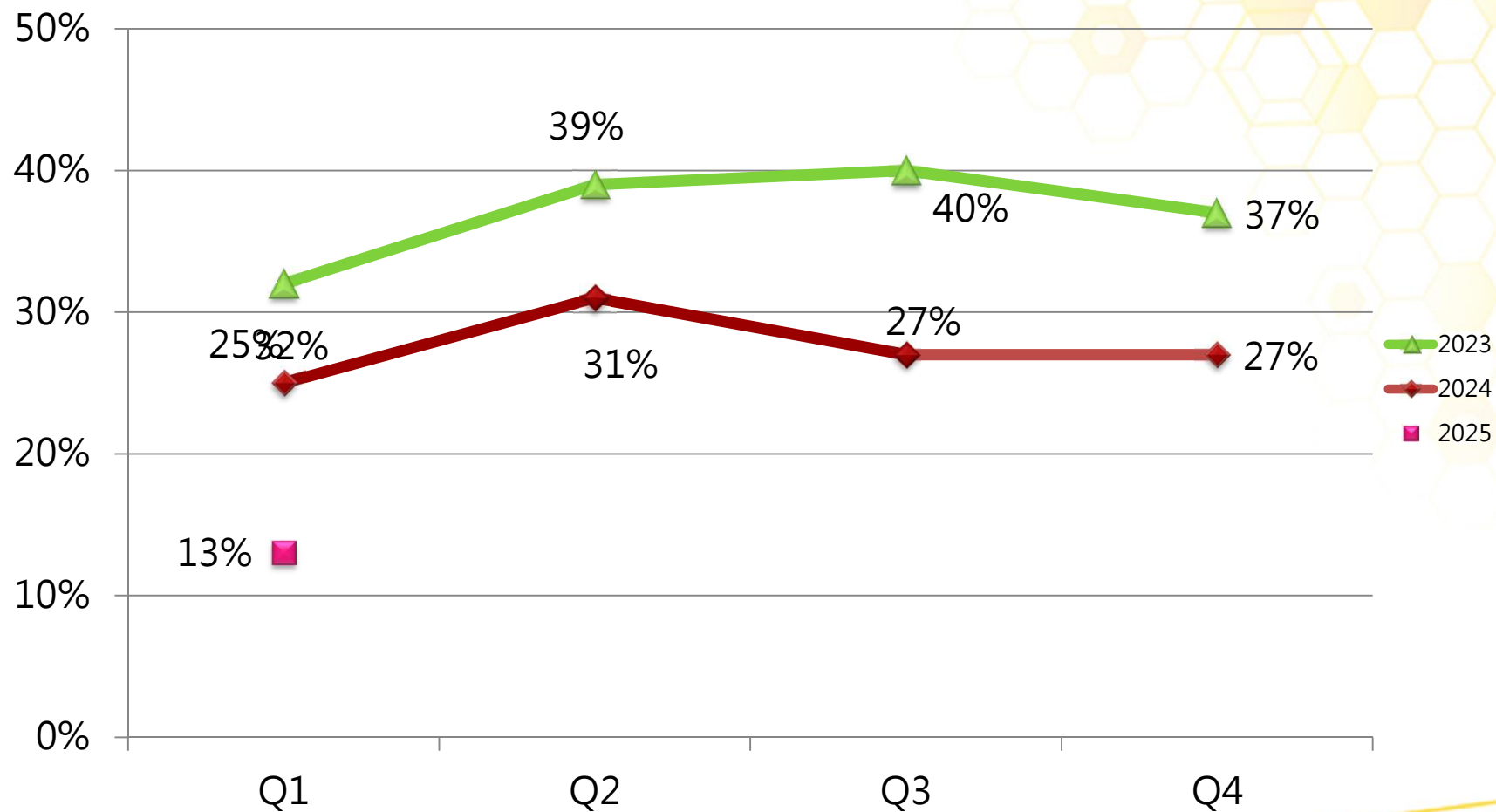
(單位：新台幣千元)



2022~2025年度 季營收趨勢

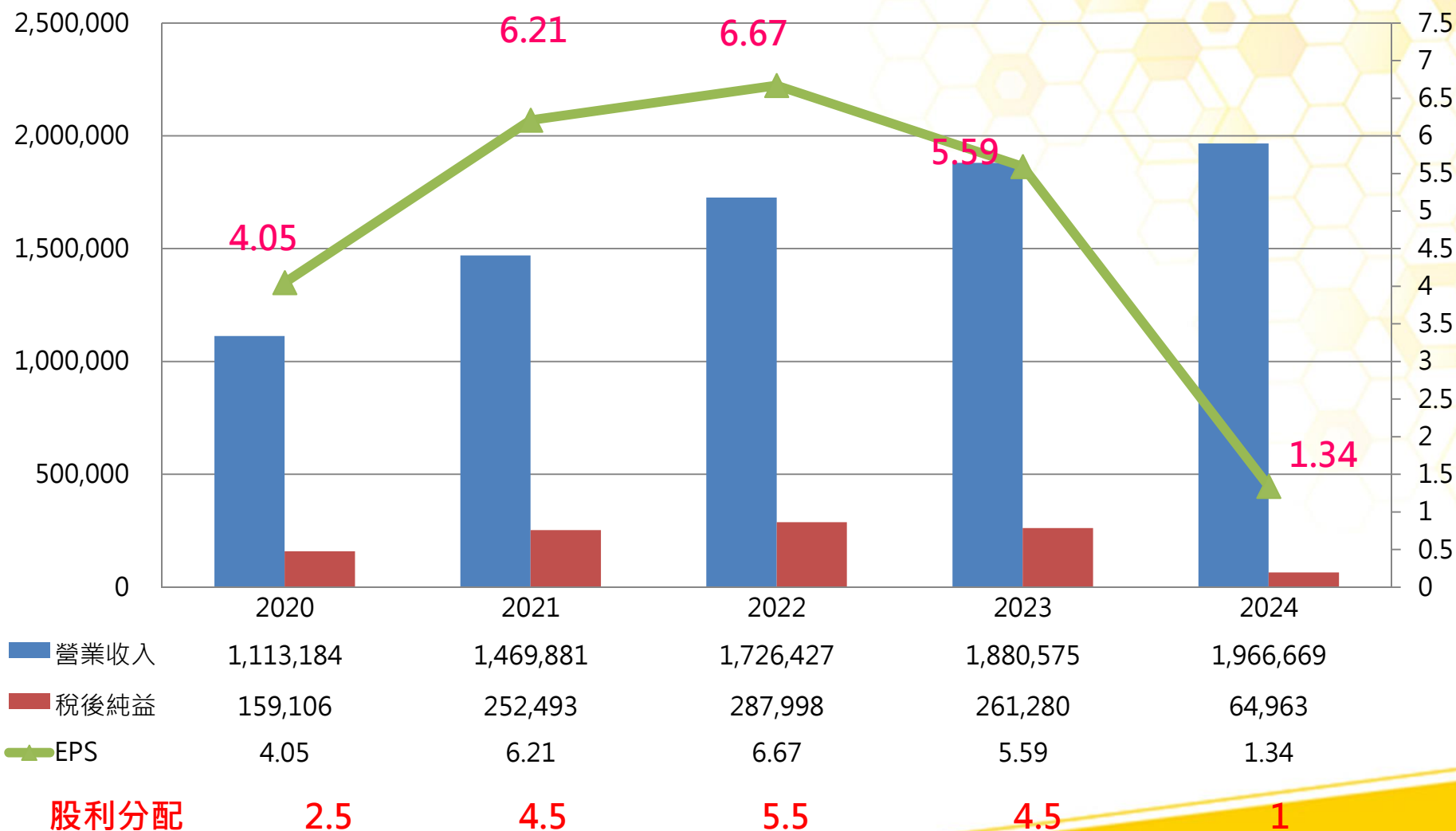


2023~2025年度 各季毛利率分析



最近五年度獲利表現與股利分配

單位:新台幣千元/元





感謝聆聽，敬請指導



Your best R&D partner

 1F, NO.27, Pu-ding Rd., Hsin-chu
30072, Taiwan, R.O.C

 +886-3-6663298

 service@msscorps.com